

技術詞彙表

本技術詞彙表載有本文件內所用若干技術詞彙的釋義。因此，該等詞彙及其涵義未必與業內標準涵義或用法一致。

「ADC」	指	模擬數字轉換器，將模擬信號轉換成數字數據的轉換器
「APS-C」	指	先進攝影系統—C型，又名先進攝影系統—經典型，測量CMOS圖像傳感器光學尺寸的規範，參考CMOS圖像傳感器光學尺寸時一般為29.3mm
「AR」	指	增強現實
「面陣」或 「面陣傳感器」	指	CMOS圖像傳感器的一種形式，其像素排列成二維矩陣，允許其在一次曝光中捕獲完整的二維圖像
「BSI」	指	背照式，一種CMOS圖像傳感器設計，光線直接進入捕捉部分，沒有電線阻礙，這使得傳感器可以捕捉更多的光線
「CAGR」	指	複合年增長率
「CCD」	指	電荷耦合器件
「CFA」	指	色彩濾波陣列
「CIS」	指	CMOS圖像傳感器
「CMOS」	指	互補金屬氧化物半導體，傳感器的製造工藝。「CMOS圖像傳感器」是使用CMOS技術的圖像傳感器
「DSC」	指	數碼相機
「DSLR」	指	數字單鏡頭反光相機
「直接飛行時間」	指	一種通過直接測量光脈衝從發射器到物體並返回到傳感器的行進時間來計算深度的距離測量方法
「ECCN」	指	出口管制分類編號，一種五個字符的字母數字代碼，用於為美國出口管制目的對物品進行分類
「EDA」	指	電子設計自動化
「FPD」	指	平板顯示器
「FPGA」	指	現場可編程門陣列，一種半導體傳感器，可在製造後編程和重新配置，以執行不同的數字邏輯功能
「fps」	指	每秒幀數

技術詞彙表

「FSI」	指	前照式，傳統的CMOS圖像傳感器設計，其中光從光電二極管的電路側面進入。由於部分光線被布線阻擋，傳感器捕獲的光線較少
「Gbps」	指	千兆位每秒
「GDS」	指	圖形數據庫系統，一種集成電路版圖的文件格式
「Gpix/s」	指	每秒千兆像素
「HDR」	指	高動態範圍，一種捕獲、處理及再現視頻內容或圖像的方式，其可增加場景的陰影與高光細節
「IC」或「集成電路」	指	集成電路，一種微型電子器件或元件，使用半導體技術製造，將電路所需的所有晶體管、電阻器、電容器、電感器及其連接線集成到一個半導體晶片(如硅芯片或襯底)上，然後將其焊接並封裝在外殼內，形成具有所需電路功能的電子器件
「IDM」	指	集成器件製造商，一家設計、製造及銷售集成電路(IC)產品的半導體公司
「IR」	指	紅外線，一種電磁輻射，波長剛好大於可見光光譜的紅端，但小於微波
「ISO」	指	國際標準化組織，一個獨立的非政府組織，負責制定及發佈國際標準
「間接飛行時間」	指	一種通過分析發射的調製光和接收的反射光之間的相移來估計深度的距離測量方法
「ISP」	指	圖像信號處理器，數字成像設備中負責捕獲、處理及增強來自相機傳感器的圖像硬件組件或子系統
「LED」	指	發光二極管，當施加電壓時發光的半導體二極管
「線陣」或 「線陣傳感器」	指	CMOS圖像傳感器的一種形式，其特徵在於像素排列在線上，並通過掃描以垂直於傳感器方向的恆定速度移動的物體來捕獲2D圖像
「MHz」	指	兆赫，等於一百萬赫茲的交流電或電磁波頻率單位
「MP」	指	百萬像素，用於描述數碼相機和圖像傳感器分辨率的度量

技術詞彙表

「MWh」	指	兆瓦時，電能計量單位
「OEM」	指	原始設備製造商，生產零件或設備然後由另一家公司營銷及銷售的公司
「OLED」	指	有機發光二極管，一種用於平板顯示器的LED技術，其中發射電致發光層是響應電流而發光的有機化合物薄膜
「光學格式」	指	圖像傳感器的尺寸，以CMOS圖像傳感器實際接收光線區域的對角線長度計量
「OSAT」	指	外包半導體封裝與測試
「PCB」	指	印刷電路板，用於固定及連接電路元件的機械底座
「光掩模」	指	一種不透明板，用於在晶圓製造過程中將電路佈局複製到晶圓上
「產消者」	指	它是指介於專業和消費市場之間的用户細分市場，如高級攝影愛好者、半專業內容創作者或小型工作室，他們需要比普通消費者更高的成像性能，但成本和複雜性低於專業級解決方案
「研發」	指	研究及開發
「輸出速度」	指	從圖像傳感器提取像素數據的速率，影響圖像捕獲速度和運動失真
「sCMOS」	指	科學級CMOS，一種新的傳感器技術，主要用於增強科學及工業應用中的成像
「sq.m.」	指	平方米
「TDI」	指	時間延遲積分，一種用於線掃描照相機的先進成像技術，用於捕捉快速移動物體的高質量圖像，尤其是在弱光條件下
「ToF」	指	飛行時間，一種用於測量傳感器和物體之間距離的方法，該方法基於在被物體反射之後信號的發射和信號返回到傳感器之間的時間或相位差。飛行時間可進一步分類為直接飛行時間（「dToF」）和間接飛行時間（「iToF」）
「ultra-HD」	指	超高清，包括4K和8K數字視頻格式
「VR」	指	虛擬現實
「WLCSP」	指	晶圓級芯片尺寸封裝，芯片直接封裝在晶圓級的一種半導體封裝